

# 工信部将持续推进半导体材料等产业发展 半导体材料迎发展良机

——电子行业周报



评级 增持（维持）

2019年10月13日

曹旭特 分析师

SAC 执业证书编号: S1660519040001

## 投资摘要:

### 市场回顾:

本周(2019.10.07-2019.10.11)上证指数上涨2.36%，深证成指上涨2.33%，创业板指上涨2.41%，申万电子指数上涨0.99%，位列申万28个一级行业涨跌幅第25位。目前，电子板块TTM市盈率为37.7倍，位列申万28个一级行业的第5位。

- 股价涨幅前五名分别是：蓝思科技、伊戈尔、恒铭达、飞荣达、GQY视讯；
- 股价跌幅前五名分别是：欣旺达、大华股份、宇瞳光学、木林森、睿能科技。

每周一谈：工信部将持续推进半导体材料等产业发展 半导体材料迎发展良机

8日，工信部网站发布《关于政协十三届全国委员会第二次会议第2282号(公交邮电类256号)提案答复的函》，称下一步将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展，根据产业发展形势，调整完善政策实施细则，更好的支持产业发展。

答复函从四个方面回复了如何持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展。

- **积极研究出台政策支持产业发展：**为推动我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展，我部、发展改革委及相关部门，积极研究出台政策支持产业发展。
- **从开放合作，加强交流方面推动我国工业半导体芯片材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展：**积极支持国内企业、高校、科研院所与先进发达国家加强交流合作。引进国外先进技术和研发团队，支持海外高层次产业人才来华发展，提升我国在工业半导体芯片相关领域的研发能力和技术实力。
- **积极支持工业半导体材料、芯片、器件、IGBT模块领域关键技术攻关：**工业强基IGBT器件一条龙应用计划、指导湖南省建立功率半导体制造业创新中心建设等，积极部署新材料及新一代产品技术的研发。
- **积极推动我国相关产业人才的培养：**进一步加强人才队伍建设，推进设立集成电路一级学科，进一步做实做强示范性微电子学院，加快建设集成电路产教融合协同育人平台。

半导体材料细分品种多，我们更看好光刻胶和硅片。

- 我们看好光刻胶特别是PCB光刻胶领域的前景。原因是随着国内5G商用的落地，5G基站建设将迎来高峰期，PCB行业迎来需求爆发，这将带动国内PCB光刻胶需求的大幅增加；
- 受益于国内晶圆厂的大量投建，以及光伏行业回暖对硅片需求的回升，国内硅片的需求量将大大增加。我们看好硅片生产商在后续的发展机遇。

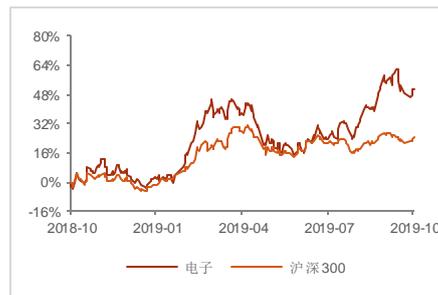
**投资策略及组合：**受益于行业整体的快速成长和国产化替代进程的推进，国内半导体材料企业将迎来黄金发展期。建议关注半导体材料细分领域龙头企业，特别是光刻胶和硅片领域龙头企业。推荐组合：中环股份、容大感光、强力新材、晶瑞股份、安集科技各20%。

**风险提示：**行业发展不及预期；下游需求低于预期；研发进度不及预期。

## 行业基本资料

股票家数	249
行业平均市盈率	72.73
市场平均市盈率	17.26

## 行业表现走势图



资料来源：申港证券研究所

## 相关报告

- 1、《电子行业研究周报：从中环领先集成电路用大直径硅片项目看国内硅片情况》2019-10-07
- 2、《电子行业研究周报：电子板块大跌机会还是风险？》2019-09-29
- 3、《电子行业深度研究：行业基石 一材难求》2019-09-26

## 1. 每周一谈：工信部将持续推进半导体材料等产业发展 半导体材料迎发展良机

### 1.1 工信部：将持续推进工业半导体材料、芯片等产业发展

8日，工信部网站发布《关于政协十三届全国委员会第二次会议第2282号(公交邮电类256号)提案答复的函》，称下一步将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展，根据产业发展形势，调整完善政策实施细则，更好的支持产业发展。

答复函从四个方面回复了如何持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展。

**一、积极研究出台政策扶持产业发展。**为推动我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展，我部、发展改革委及相关部门，积极研究出台政策扶持产业发展。

- ◆ 2014年国务院发布的《推进纲要》中，已经将工业半导体芯片相关产品作为发展重点，通过资金、应用、人才等方面政策推动产业进步。
- ◆ 发展改革委、我部研究制定了集成电路相关布局规划，推动包括工业半导体材料、芯片等产业形成区域集聚、主体集中的良性发展局面。
- ◆ 按照国发〔2011〕4号文件的有关要求，对符合条件的工业半导体芯片设计、制造等企业的企业所得税、进口关税等方面出台了多项税收优惠政策，对相关领域给予重点扶持。
- ◆ 围绕能源、交通等国家重点工业领域，充分发挥相关行业组织作用，通过举办产用交流对接会、新产品推介会、发布典型应用示范案例等方式，为我国工业半导体芯片企业和整机企业搭建交流合作平台。

下一步，根据产业发展形势，调整完善政策实施细则，更好的支持产业发展。通过行业协会等加大产业链合作力度，深入推进产学研用协同，促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的技术迭代和应用推广。

**二、从开放合作，加强交流方面推动我国工业半导体芯片材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展。**

积极支持国内企业、高校、研究所与先进发达国家加强交流合作。引进国外先进技术和研发团队，推动包括工业半导体芯片、器件等领域国际专家来华交流，支持海外高层次产业人才来华发展，提升我国在工业半导体芯片相关领域的研发能力和技术实力。

下一步，我部和相关部门将继续加快推进开放发展。引导国内企业、研究机构等加强与先进发达国家产学研机构的战略合作，进一步鼓励我国企业引进国外专家团队，促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业研发能力和产业能力的提升。

### 三、积极支持工业半导体材料、芯片、器件、IGBT 模块领域关键技术攻关。

- ◆ 2017 年推出“工业强基 IGBT 器件一条龙应用计划”，针对新能源汽车、智能电网、轨道交通三大领域，重点支持 IGBT 设计、芯片制造、模块生产及 IDM、上游材料、生产设备制造等环节，促进 IGBT 及相关产业的发展。
- ◆ 指导湖南省建立功率半导体制造业创新中心建设，整合产业链上下游资源，协同攻关工业半导体材料、芯片、器件、IGBT 模块领域关键共性技术。
- ◆ 指导中国宽禁带半导体及应用产业联盟发布《中国 IGBT 技术与产业发展路线图（2018-2030）》，引导我国 IGBT 行业技术升级，推动相关产业发展。

下一步，我部将继续支持我国工业半导体领域成熟技术发展，推动我国芯片制造领域良率、产量的提升。积极部署新材料及新一代产品技术的研发，推动我国工业半导体材料、芯片、器件、IGBT 模块产业的发展。

### 四、积极推动我国相关产业人才的培养。

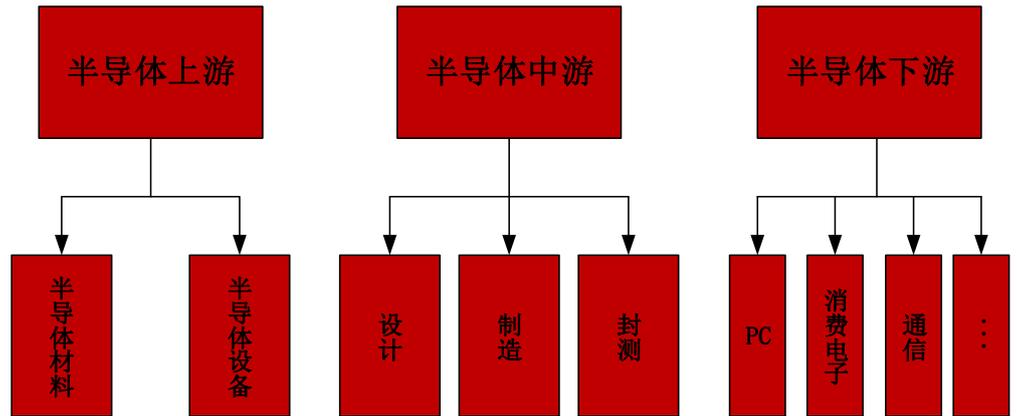
- ◆ 我部、教育部共同推动筹建集成电路产教融合发展联盟，促进产业界和学术界的资源整合，推动培养拥有工程化能力的产业人才。
- ◆ 同时以集成电路为试点实施关键领域核心技术紧缺博士人才自主培养专项，根据行业企业需要，依托高水平大学和国内骨干企业，针对性地培养一批高端博士人才。
- ◆ 教育部、我部等相关部门印发了《关于支持有关高校建设示范性微电子学院的通知》，支持 26 所高校建设或筹建示范性微电子学院，推动高校与区域内集成电路领域骨干企业、国家公共服务平台、科技创新平台、产业化基地和地方政府等加强合作。

下一步，我部与教育部等部门将进一步加强人才队伍建设。推进设立集成电路一级学科，进一步做实做强示范性微电子学院，加快建设集成电路产教融合协同育人平台，保障我国在工业半导体材料、芯片、器件及 IGBT 模块产业的可持续发展。

## 1.2 半导体材料是半导体产业链重要支撑

从日韩贸易战可以看出，**半导体材料有着极其重要的地位**，关键时刻能作为维护国家利益的重要手段。半导体材料处于半导体产业链的上游，是半导体行业的物质基础。材料质量的好坏决定了最终集成电路芯片质量的优劣。因此，半导体材料在整个产业链中有着重要地位，是整个半导体产业链的重要支撑。

图1：半导体产业链

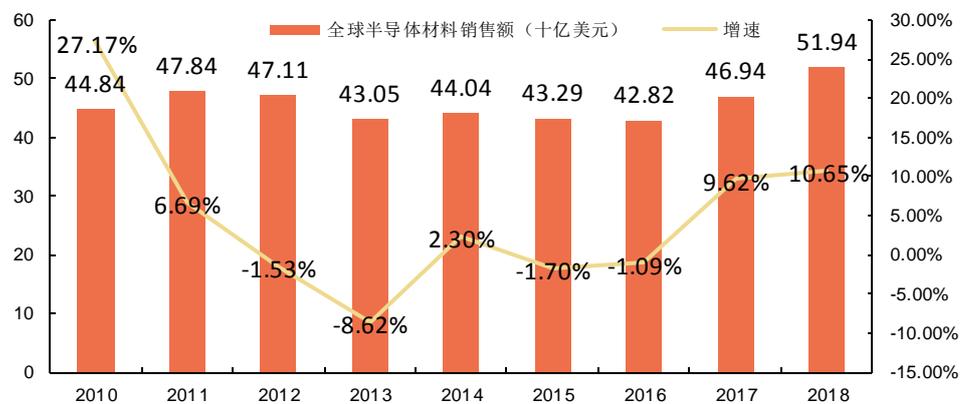


资料来源：wind，申港证券研究所

### 1.3 2018 年全球半导体材料销售额创历史新高

2018 年全球半导体材料销售额 519.4 亿美元，销售额首次突破 500 亿美元创下历史新高。2018 年全球半导体材料销售增速 10.65%，也创下了自 2011 年以来的新高。

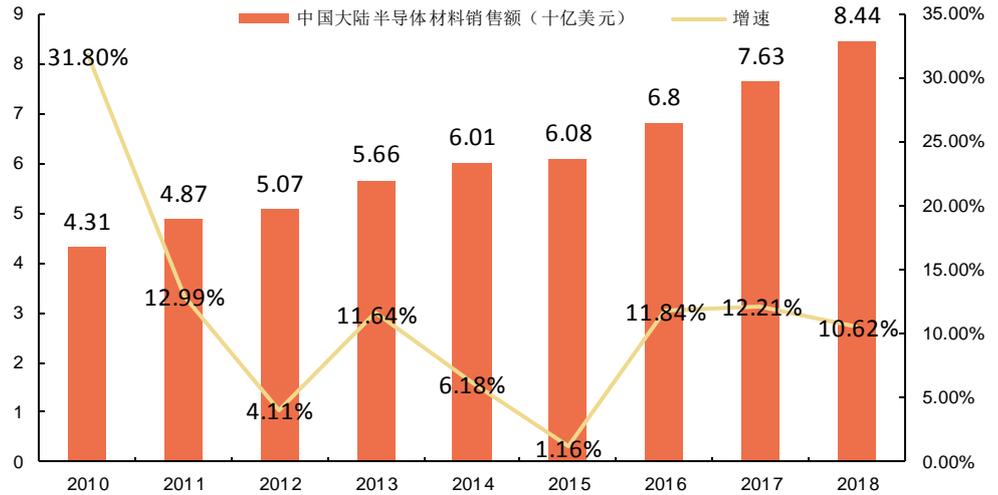
图2：全球半导体材料销售额及增速



资料来源：wind，申港证券研究所

近年来，中国大陆半导体材料的销售额保持稳步增长。2018 年大陆半导体材料销售额 84.4 亿美元，增速 10.62%，销售额创下历史新高。

图3: 中国大陆半导体材料销售额及增速



资料来源: wind, 申港证券研究所

#### 1.4 半导体材料技术壁垒高 国内部分领域实现技术突破

半导体材料属于高技术壁垒行业,特别是晶圆制造材料,技术要求高,生产难度大。目前,半导体材料高端产品大多集中在美国、日本、德国、韩国、中国台湾等国家和地区生产商。国内由于起步晚,技术积累不足,整体处于相对落后的状态。目前,国内半导体材料主要集中在中低端领域,高端产品基本被国外生产商垄断。如硅片,2017年全球五大硅片厂商占据了全球94%的市场份额。

但在一些细分领域,国内已有企业突破国外技术垄断,在市场占有一定的份额。

- ◆ **光刻胶:** 北京科华目前 KrF (248nm) 光刻胶目前已经通过中芯国际认证, ArF (193nm) 光刻胶正在积极研发中; 晶瑞股份子公司苏州瑞红 i 线光刻胶已向中芯国际、扬杰科技、福顺微电子等客户供货, KrF (248nm) 光刻胶完成中试, 产品分辨率达到了 0.25~0.13 $\mu$ m 的技术要求, 建成了中试示范线。
- ◆ **硅片:** 中环股份电力电子器件用半导体区熔单晶硅片综合实力全球第三, 国外市场占有率超过 18%, 国内市场占有率超过 80%; 光伏单晶研发水平全球领先, 单晶硅片产能约为 30GW, 市占率约为 30%。
- ◆ **CMP 抛光液:** 安集科技 CMP 抛光液已在 130-28nm 技术节点实现规模化销售, 主要应用于国内 8 英寸和 12 英寸主流晶圆产线; 14nm 技术节点产品已进入客户认证阶段, 10-7nm 技术节点产品正在研发中。
- ◆ **CMP 抛光垫:** 鼎龙股份 8 英寸抛光垫已经获得国内晶圆厂华虹半导体和士兰微的认证并且取得订单, 12 英寸抛光垫已经获得中芯国际的认证。2019 年上半年已经获得第一张 12 英寸抛光垫订单, 下半年预计将是 12 寸客户订单的收获期。

#### 1.5 投资建议

半导体材料细分品种多, 我们看好光刻胶领域标的公司未来的发展, 特别是 PCB 光刻胶领域的前景。原因是随着国内 5G 商用的落地, 5G 基站建设将迎来高峰期, PCB 行业将迎来需求爆发。5G 基站采用 Massive MIMO 技术, 将 RRU 与天线一体化为 AAU, 这将显著增加 PCB 的使用面积。预计 PCB 的使用面积将从 4G RRU 的 0.15m<sup>2</sup> 提高到 5G AAU 的 0.3m<sup>2</sup>, 这将带动国内 PCB 光刻胶需求的大幅增加。

硅片是半导体行业最重要的材料，约占整个晶圆制造材料价值的三分之一。2018 年全球半导体硅片销售金额为 113.8 亿美元，同比 2017 年增长 30.65%。受益于国内晶圆厂的大量投建，以及光伏行业回暖对硅片需求的回升，国内硅片的需求量将大大增加。我们看好硅片生产商在后续的发展机遇。

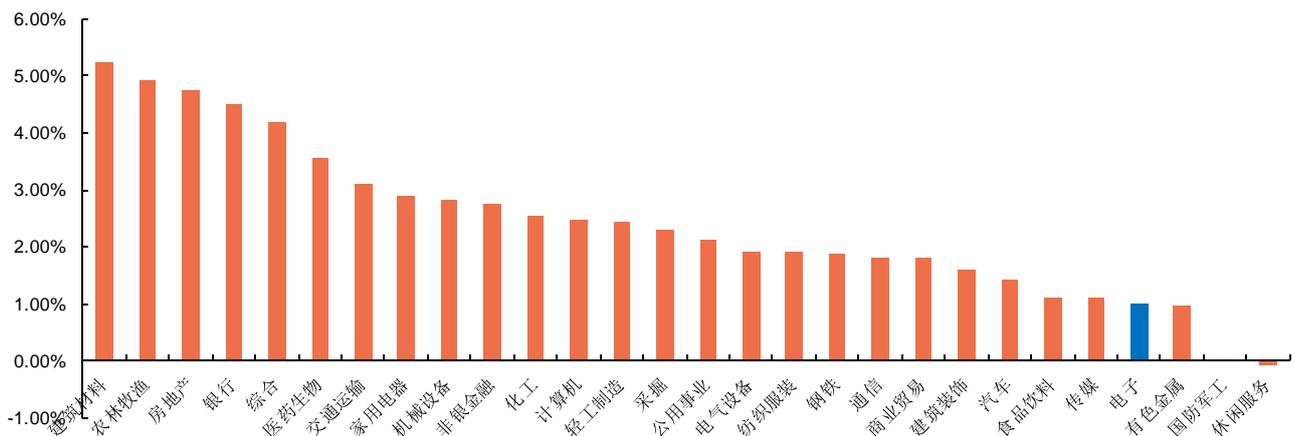
我们建议关注半导体材料各细分领域龙头企业。推荐关注光刻胶领域龙头**容大感光**、**强力新材**及**晶瑞股份**、大硅片生产商**中环股份**、CMP 抛光垫龙头**鼎龙股份**以及 CMP 抛光液生产商**安集科技**。

## 2. 市场回顾

本周（2019.10.07-2019.10.11）上证指数上涨 2.36%，深证成指上涨 2.33%，创业板指上涨 2.41%，申万电子指数上涨 0.99%，位列申万 28 个一级行业涨跌幅第 25 位。目前，电子板块 TTM 市盈率为 37.7 倍，位列申万 28 个一级行业的第 5 位。

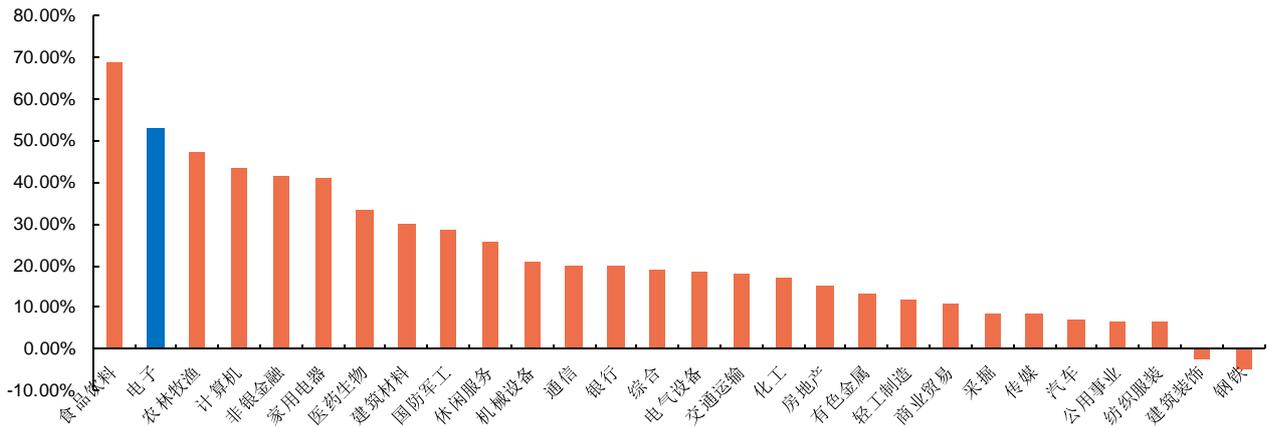
自 2019 年初至今，上证综指、深证成指、创业板指、申万电子指数分别上涨 19.24%、33.52%、33.29%、52.97%，电子指数在申万一级行业排名涨跌幅第 2 名。

图4：申万一级行业指数周涨跌幅



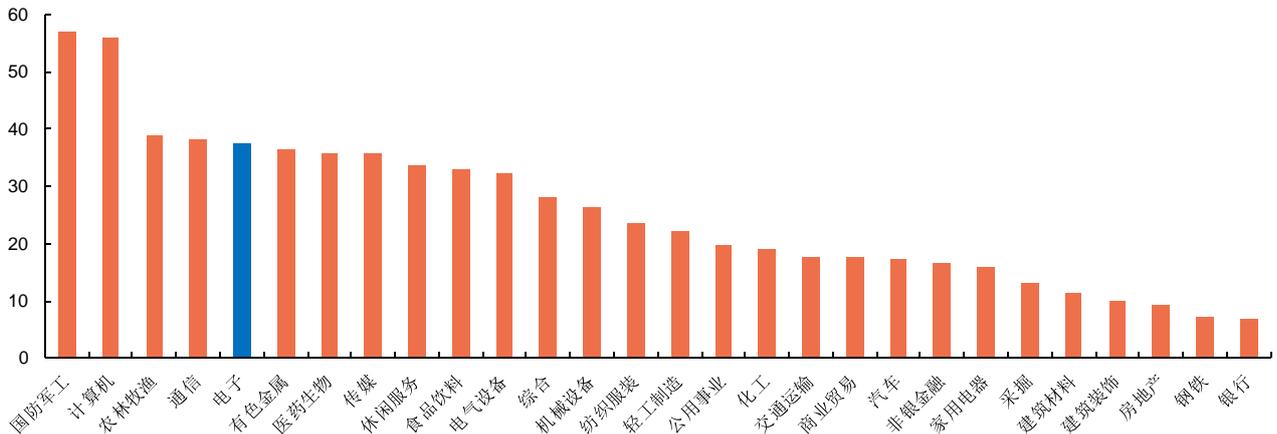
资料来源：wind，申港证券研究所

图5: 申万一级行业年初至今涨跌幅对比



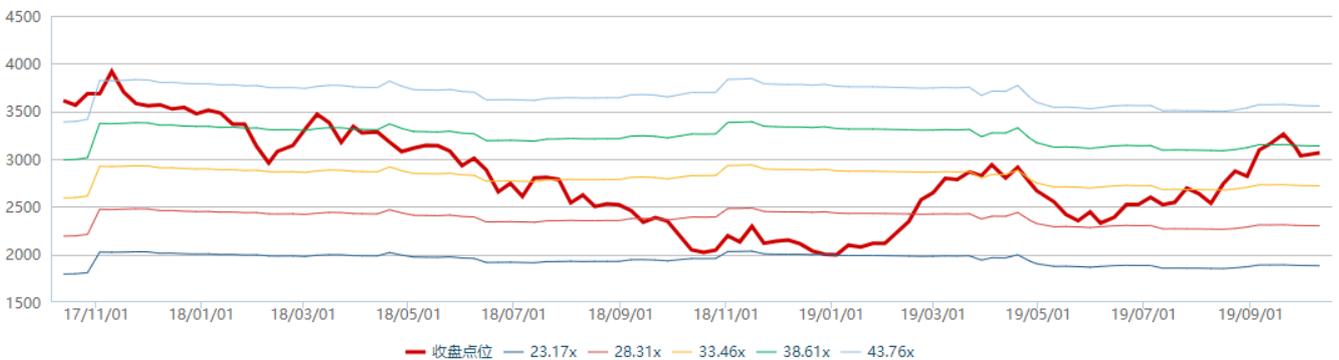
资料来源: wind, 申港证券研究所

图6: 申万一级行业 PE (TTM) 对比



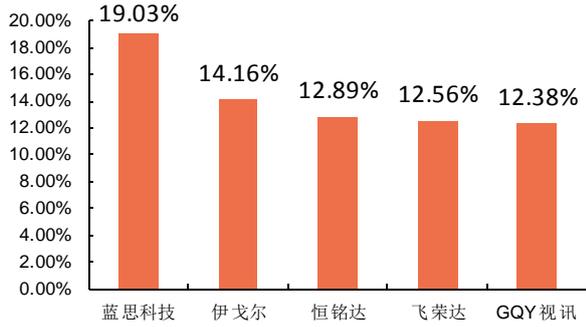
资料来源: wind, 申港证券研究所

图7: 电子行业估值水平(PE-TTM)

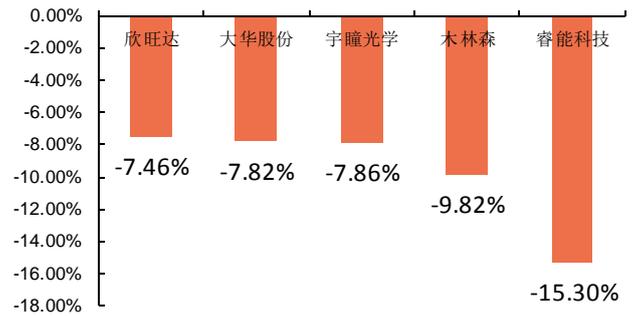


资料来源: wind, 申港证券研究所

个股方面, 本周涨幅前五的股票是蓝思科技、伊戈尔、恒铭达、飞荣达、GQY 视讯; 跌幅靠前的是欣旺达、大华股份、宇瞳光学、木林森、睿能科技。

**图8: SW 电子成分本周涨幅前 5**


资料来源: wind, 申港证券研究所

**图9: SW 电子成分本周跌幅前 5**


资料来源: wind, 申港证券研究所

## 3. 行业新闻

### 3.1 半导体

**工信部: 持续推进工业半导体材料、芯片、器件及 IGBT 模块产业发展。**10月8日消息, 据工信部网站发布的消息, 工信部日前复函政协十三届全国委员会第二次会议第 2282 号提案表示, 将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及 IGBT 模块产业发展, 根据产业发展形势, 调整完善政策实施细则, 更好的支持产业发展。通过行业协会等加大产业链合作力度, 深入推进产学研用协同, 促进我国工业半导体材料、芯片、器件及 IGBT 模块产业的技术迭代和应用推广。

**台积电今年 9 月营收达 237 亿元 同比增长 7.6%。**10月9日消息, 台湾地区半导体制造商台积电刚刚公布了 9 月营收报告。台积电 9 月合并营收约为新台币 1,021 亿 7,000 万元 (约合人民币 237 亿元), 较上月减少了 3.7%, 较去年同期增加了 7.6%。台积电 2019 年 1 至 9 月累计营收约为新台币 7,527 亿 4,800 万元, 较去年同期增加了 1.5%。

**Qorvo 宣布已收购 Cavendish Kinetics。**射频解决方案供应商 Qorvo 宣布, 已收购全球领先的高性能射频供应商 Cavendish Kinetics, 该公司的团队将继续推动 RF MEMS(射频微机电系统)技术在 Qorvo 产品线中的应用, 并将该技术转变为用于移动设备和其他市场的大批量制造。

**芯和半导体在上海张江成立。**10月9日, 苏州芯禾电子科技有限公司的全体股东宣布在上海张江成立“芯和半导体科技(上海)有限公司”, 并将芯禾科技纳入芯和半导体旗下, 同时正式启用全新的 EDA 软件品牌名称“芯和”。“芯和”品牌的启用标志着企业对 EDA 软件事业定位的全面升级。随着“芯和”时代的到来, 企业将承担串联起从芯片设计到芯片制造的半导体生态链的重任, “和”EDA 生态圈的各个伙伴无缝交互、“和”半导体产业链上下游的企业紧密融合, 提供覆盖芯片、封装到系统设计的全面解决方案, 更好地服务全中国乃至全球的客户。

**默克完成对 Versum Materials 公司的收购。**全球领先的科技公司默克 2019 年 10 月 7 日宣布以约 58 亿欧元的价格完成对 Versum Materials(简称“Versum”)公司的收购。此次合并将进一步推动默克成为半导体和显示行业领先的电子材料供应商。此次收购将使默克公司全球员工人数增加约 2,300 名, 默克公司将在全球 66 个国家和地区拥有近 56,000 名员工。截至 2022 年, 即交易完成后的第三个完整年度,

并购带来的年度协同运营收益预计将达到 7,500 万欧元。

**瑞萨电子面向智能物联网应用推出 RA 产品家族 MCU。**2019 年 10 月 8 日，全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出基于 32 位 Arm®Cortex®-M 内核的 Renesas Advanced (RA)MCU 产品家族。RA MCU 提供优化性能、安全性、连接性、外设 IP 和易于使用的 Flexible Software Package (灵活配置软件包, FSP) 的终极组合，以满足下一代嵌入式解决方案的需求。为了支持这一全新的产品家族，瑞萨建立了一个全面的合作伙伴生态系统，为 RAMCU 提供了一系列软件与硬件组件，做到开箱即用。

**三星率先开发出 12 层 3D 硅穿孔堆叠 HBM 存储芯片容量提至 24GB。**近日，三星电子宣布率先在业内开发出 12 层 3D-TSV(硅穿孔)技术。随着集成电路规模的扩大，如何在尽可能小的面积内塞入更多晶体管成为挑战，其中多芯片堆叠封装被认为是希望之星。三星称，他们得以将 12 片 DRAM 芯片通过 60000 个 TSV 孔连接，每一层的厚度仅有头发丝的 1/20。总的封装厚度为 720 $\mu$ m，与当前 8 层堆叠的 HBM2 存储芯片相同，体现了极大的技术进步。这意味着，客户不需要改动内部设计就可以获得更大容量的芯片。同时，3D 堆叠也有助于缩短数据传输的时间。基于 12 层 3DTSV 技术的 HBM 存储芯片将很快量产，单片容量从目前的 8GB 来到 24GB。

**ARM 首款 5nm LPE 芯片曝光：功耗降低 20%。**据外媒报道，ARM 即将推出的全新下一代 CPU，代号为“Hercules”的芯片将采用三星最新的 5nm LPE 工艺，预计最快将于 2020 年登场。高通，三星，华为等移动 SoC 设计公司可以利用这些工具和 IP(中断优先寄存器)开发下一代处理器，以用于未来的智能手机和平板电脑。

**新思科技完成对 QTronic GmbH 的收购。**10 月 10 日消息，据国外媒体报道，新思科技 (Synopsys, Inc.) 近日宣布已完成收购总部设在德国的汽车软件和系统开发仿真、测试工具和相关服务的企业 QTronic GmbH。QTronic GmbH 成立于 2006 年，是汽车软件虚拟验证工具的供应商。它的旗舰产品包括一个将开发任务从公路和测试平台转移到微软 Windows PC 的虚拟 ECU 平台 Silver，以及一种具有强大的测试用例生成器、只需最小规格的智能测试自动化解决方案 TestWeaver。新思科技表示，QTronic 仿真和测试工具将加速新思科技为整个汽车电子供应链的系统 and 软件开发提供全面的汽车虚拟原型解决方案。

### 3.2 消费电子

**三星电子：将投资 110 亿美元开发下一代显示器产品。**三星显示器公司计划投资 13.1 万亿韩元 (约 110 亿美元)，用于开发和制造下一代显示器产品，以此来应对来自中国竞争对手的供应和价格压力。该公司在一份声明中表示，他们将在峨山建立一条量子点显示器生产线，并将于 2021 年开始投产，初期年产能为 3 万块大于 65 英寸的面板。之后产能将会有所提升，该公司还制定了一个截止到 2025 年的长期发展计划。该公司补充说，这项投资将会创造 8.1 万个就业岗位。

**英特尔推出全新 W-2200 Xeon 芯片。**10 月 8 日，英特尔正式发布了全新的 W-2200 Cascade Lake-X Xeon 芯片，该芯片将适用于苹果即将推出的最新款 iMac Pro 产品。目前，苹果为其 iMac Pro 型号使用定制的 Intel Xeon-W 芯片，不过也可以使用 W-2200 Xeon 芯片的普通版本或定制版本。在全新 W-2200 芯片中拥有最多 18

颗 AVX 512 的内核，以及 48 个 PCIe 通道，Turbo Boost Max 3.0 和 AI 加速（英特尔的深度学习 Boost 功能），可用于视觉效果，动态图形，3D 渲染等工作。

**群创光电今年 9 月营收 50 亿元 同比减少 11%。** 10 月 9 日消息，台湾面板厂商群创光电今日发布了 9 月营收报告。报告显示，群创光电 2019 年 9 月自结合并营收为新台币 217 亿元（约合人民币 50 亿元），较上月增加 3.1%，较去年同期减少 11.0%。群创光电 2019 年 9 月大尺寸合并出货量共计 1,020 万片，较上月减少 1.4%；中小尺寸合并出货量共计 2,120 万片，较上月增加 2.4%。

**LG Display 在哈罗德百货橱窗展示透明 OLED 显示屏。** 10 月 9 日消息，韩国液晶面板制造商乐金显示（LG Display）正与伦敦百货公司哈罗德（Harrods）合作，在 10 月 7 日至 28 日期间，在后者的百货商店橱窗里展示其巨大的透明 OLED 显示屏。此次展示的是 LG Display 55 英寸全高清透明 OLED 显示屏，其透明度为 38%。LG Display 是世界上唯一一家生产大尺寸透明 OLED 显示器的制造商。该公司解释说，OLED 是制造透明电视的最佳显示技术，因为它不需要背光，而且可以自己发光。透明显示屏也非常适合商业用途，因为客户可以在直接看玻璃另一边产品的同时看到特定产品的信息。

**友达光电第三季度营收达 162 亿元 同比减少 13.6%。** 10 月 8 日消息，台湾面板厂商友达光电今天公布的数据显示，该公司第三季度营收为新台币 700.5 亿元（约合人民币 162 亿元），同比减少 13.6%。友达光电 2019 年 9 月自行结算合并营收为新台币 238.7 亿元，较上月减少 1.1%，与去年同期相比减少 13.0%。累计 2019 年第三季合并营业额为新台币 700.5 亿元，与 2019 年第二季持平，与 2018 年同期相比减少 13.6%。9 月份整体大尺寸面板出货量包括液晶电视、桌上型显示器及笔记本电脑面板等约 1,032 万片，较 8 月份增加 3.7%。中小尺寸面板出货量超过 1,137 万片，较 8 月份减少 3.2%。2019 年第三季大尺寸面板出货量超过 2,867 万片，较 2019 年第二季增加 5.5%，与去年同期相比减少 3.7%。2019 年第三季中小尺寸面板出货量约 3,560 万片，与 2019 年第二季相比增加 7.8%，较去年同期下降 16.4%。

#### 4. 重点公司动态

**北京君正预计第三季度净利同比增长 167.19%至 236.92%。** 10 月 12 日消息，深交所上市公司北京君正(SZ:300223)日前发布了 2019 年前三季度业绩预告。报告显示，北京君正预计 2019 年第三季度盈利 2,386.64 万元至 3,009.45 万元，同比增长 167.19%至 236.92%。北京君正上年同期盈利 893.23 万元。北京君正预计，公司今年前三季度盈利 6,082.82 万元至 6,705.63 万元，比上年同期增长 192.53%至 222.48%。北京君正称，报告期内，由于公司在物联网及智能视频领域的销售持续增长，尤其是在智能视频领域增长较快，致公司总体营业收入较去年同比增长。同时，本报告期公司收到的理财收益、政府补助较去年同比增长。

**TCL 集团累计回购 3.66%公司股份 斥资 16.89 亿元。** 10 月 9 日消息，半导体显示技术公司 TCL 集团(SZ:000100)今晚发布了关于回购公司股份的回购进展公告。TCL 集团累计回购 3.66%公司股份，斥资 16.89 亿元。公告称，2019 年 10 月 9 日，TCL 集团股份有限公司(以下简称“公司”)回购 470.27 万股，成交金额 1,642.03 万元，成交均价 3.49 元。自首次实施回购至 2019 年 10 月 9 日，公司已通过回购

专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 496,508,222 股，占公司总股本的 3.66%，最高成交价为 4.17 元/股，最低成交价为 3.13 元/股，成交均价为 3.40 元/股，成交总金额为 168,888 万元（不含交易费用）。

**海康威视：多数元器件都可替代 有需要可以自研芯片。**10 月 8 日，海康威视、大华股份、科大讯飞、旷视科技、商汤科技等 8 家中国公司，被美国商务部列入实体名单。对于此事可能带来的影响，海康威视公司总裁胡扬忠先生以及董事会秘书黄方红女士，通过电话会议与投资者进行了沟通交流。胡扬忠表示，大家对于芯片的重视度过高了，近两年海康也在做自己的芯片，但是我们没有过多对外披露，实际上得益于当下的芯片设计业的 IP 共享策略，所以做芯片没有那么复杂。黄方红也表示，公司可以提供其他方案替代美国供应链，芯片受限制我们换芯片，换不了芯片我们换组件，换不了组件的我们重新设计，如果有需要，我们自己设计芯片。

**深天马 A 拟申请发债不超 30 亿元。**10 月 12 日消息，昨日，深交所上市公司、半导体显示技术公司天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马 A”，股票代码 000050）发布了关于公开发行人公司债券的预案，该公司拟申请公开发行不超 30 亿元公司债券。该公司在公告中表示，经天马微电子股份有限公司第九届董事会第五次会议审议通过，该公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）。该事项尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

**通富微电累计回购 592 万股公司股份。**10 月 8 日消息，深交所上市公司通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”，股票代码 002156）发布公告称，截至 2019 年 9 月 30 日，该公司累计回购公司股份 592.0092 万股，占该公司总股本的 0.51%。通富微电在公告中表示，截至 2019 年 9 月 30 日，该公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 592.0092 万股，占该公司总股本的 0.51%，最高成交价为 8.80 元/股，最低成交价为 7.97 元/股，支付的总金额为 4990.0111 万元（不含交易费用）。

## 5. 风险提示

行业发展不及预期；下游需求低于预期；研发进度不及预期。

### 分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

### 风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

## 免责声明

本研究报告由申港证券股份有限公司研究所撰写，申港证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为申港证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供申港证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和法律责任。

## 行业评级体系

### 申港证券行业评级体系：增持、中性、减持

增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5% 以上
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上

市场基准指数为沪深 300 指数

### 申港证券公司评级体系：买入、增持、中性、减持

买入	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 15% 以上
增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上